03,13

Влияние переходных металлов на диэлектрические свойства алмазоподобных кремний-углеродных пленок

© А.И. Попов^{1,2}, А.Д. Баринов^{1,2}, В.М. Емец¹, Р.А. Кастро Арта³, А.В. Колобов³, А.А. Кононов³, А.В. Овчаров⁴, Т.С. Чуканова¹

 ¹ Национальный исследовательский университет "МЭИ", Москва, Россия
 ² Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН, Москва, Россия
 ³ Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия
 ⁴ Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
 E-mail: popovai2009@gmail.com

Поступила в Редакцию 28 мая 2021 г. В окончательной редакции 28 мая 2021 г. Принята к публикации 10 июня 2021 г.

Проведены исследования влияния переходных металлов на фазовый состав, электрические и диэлектрические свойства алмазоподобных кремний-углеродных пленок, изготовленных плазмохимическим разложением полифенилметилсилоксана. Получены частотные, температурные и концентрационные зависимости указанных свойств. Показано, что с увеличением концентрации металла электропроводность непрерывно возрастает, а концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь имеют минимум при концентрациях металла 0.5–2 at.%. Анализируются возможные причины этого явления.

Ключевые слова: кремний-углеродные пленки, переходные металлы, структура, электропроводимость, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, концентрационные зависимости, поляризация.

DOI: 10.21883/FTT.2021.11.51586.132

1. Введение

Аморфные алмазоподобные кремний-углеродные пленки являются относительно новым и интенсивно исследуемым видом покрытий, свободным от большинства недостатков алмазоподобных пленок аморфного углерода [1]. В [2] было показано, что высокая стабильность структурной сетки этих материалов позволяет в широких пределах управлять их свойствами методами структурной и химической модификаций. Это дает возможность получения покрытий с необходимыми механическими, трибологическими свойствами [3,4] и электропроводностью [5,6]. Вместе с тем, исследований диэлектрических свойств указанных материалов значительно меньше. В [7] проведено исследование влияния типа кремнийорганического прекурсора, из которого плазмохимическим разложением изготовлялись пленки, на их диэлектрические свойства. Влияние же на эту группу свойств введения в материал примесей практически не исследовалось. В настоящей работе представлены результаты исследования влияния химической модификации алмазоподобных кремний-углеродных пленок переходными металлами на их диэлектрические свойства.

2. Объекты и методы исследования

Объектами исследования являлись металлосодержащие кремний-углеродные пленки, изготовленные плазмохимическим разложением полифенилметилсилоксана $(CH_3)_3Si[CH_3C_6H_5SiO]_nOSi(CH_3)_3$ (PPMS) с одновременным магнетронным распылением металла (титан, гафний) на установке, описанной в [2]. Конструкция установки позволяет получать в едином технологическом цикле набор образцов с различным содержанием металла в диапазоне от 0.2 до 10 at.%, либо набор образцов с различным содержанием металла в диапазоне от 6 до 25-30 at.%. Средняя концентрация металла в образцах, полученных в едином технологическом цикле, определяется положением подложек относительно плазмотрона и магнетрона. Пленки изготавливались на подложках из монокристаллического кремния для электрономикроскопических исследований и на металлических подложках (алюминий, нержавеющая сталь) для электрофизических измерений. В последнем случае на верхней поверхности пленки методом термического осаждения формировался электрод из алюминия диаметром 5-8 mm. Толщина пленок составляла от 1 до $3 \mu m$. Температура подложкодержателя при синтезе пленок составляла 120-130°С.

Исследования структуры, фазового и элементного состава пленок проводилось методами электронной микроскопии высокого разрешения и дифракции на просвечивающем электронном микроскопе STEM/TEM Titan 80-300 (FEI, США) и методом рентгеноспектрального микроанализа на растровом электронном микроскопе Vega II SBU (Теѕсап, Чехия) с энергодисперсионным детектором Inca x-Act (Oxford Instruments, Великобритания). Исследования электрофизических и диэлектрических свойств при различных температурах, проводились на установке для комплексного измерения диэлектрических свойств материалов Novocontrol Alpha-A (Германия) и на автоматизированной системе электрофизических измерений ASEC-03E (Россия). Исследования проводились при напряжениях от 1 до 5 V, соответствующих омической области вольтамперных характеристик.

3. Исследования структуры и фазового состава пленок

Известно, что введение в кремний-углеродную пленку металлов при их содержании более 7-12 at.% (в зависимости от вида металла) приводит к образованию двухфазной системы: аморфная кремний-углеродная матрица с внедренными в нее нанокристаллами размерами единицы nm [8]. При этом, последние представляют собой либо металл (при введении платины [9] или серебра [10]), либо карбид металла МеС (при введении переходных металлов [11]). Однако, проведенные в настоящей работе исследования фазового состава металлосодержащих пленок с невысоким содержанием металла показали, что в титансодержащих пленках при концентрациях металла от 0.5 до 4.0 at.% и в гафнийсодержащих пленках с концентрацией металла от 0.5 до 2.5 at.% нанокристаллическая фаза не наблюдается на электрономикроскопических изображениях высокого разрешения и не регистрируется при дифракционных исследованиях.

В качестве примера на рис. 1, *а* и *b* приведены электроно-микроскопические изображения поперечного среза пленок и дифракционные картины от образцов с 2 аt.% титана и гафния. Для сравнения на рис. 1, *с* и *d* представлены аналогичные результаты для титан-и гафний-содержащих пленок с содержанием металла 20 аt.%.

Как видно из рисунков, на изображениях с высоким разрешением в случае пленок с низким содержанием титана (рис. 1, a) и гафния (рис. 1, b) отсутствуют признаки периодичности в расположении атомов, а дифракционная картина представляет собой диффузное гало, типичное для аморфной фазы. В противоположность этому в случае пленок с высоким содержанием титана (рис. 1, c) и гафния (рис. 1, d) на изображениях видны нанокристаллы с упорядоченным расположением атомов (отмечены белыми контурами), а электроно-

грамма от этих областей имеет выраженные рефлексы (рис. 1, d).

Следует отметить, что отсутствие признаков кристаллической фазы в полученных экспериментальных данных не является доказательством отсутствия карбида металла в исследуемых образцах. Ранее [6] было установлено, что размеры нанокристаллов карбида металла зависят от вида введенного металла. Так при близких концентрациях металла (от 15 до 19 at.%) средние диаметры нанокристаллов карбидов составляли: в случае МоС порядка 2.5 nm, в случае HfC порядка 1.5 nm, в случае TaC от 4 до 8 nm, в случае TiC менее 2 nm. Учитывая, что при высоких концентрациях металла размеры нанокристаллов карбидов гафния и титана в пленках составляют не более 2 nm, разумно предположить, что при малых концентрациях этих металлов даже в случае формирования карбидных областей в пленке (т.е. областей с химическими связями металл-углерод), эти области не фиксируются на электрономикроскопических изображениях высокого разрешения как кристаллы и лежат ниже порога чувствительности дифракционных методов (т.е. образцы являются "электроно-аморфными"). Вместе с тем, отсутствие кристаллов проводящей фазы нанометровых размеров необходимо учитывать при интерпретации концентрационных зависимостей физических свойств рассматриваемых материалов.

4. Исследования электрофизических свойств

Зависимости электропроводности титансодержащих кремний-углеродных пленок от концентрации металла при разных температурах представлены на рис. 2. Там же приведена зависимость для гафнийсодержащих пленок при комнатной температуре.

Как и в случаях других металлов [6], введение титана и гафния в кремний-углеродную пленку вызывает рост электропроводности. Увеличение электропроводности пленок с ростом концентрации переходного металла, как правило, объясняют увеличением объема проводящих включений в пленке вследствие образования нанокристаллов карбида металла и соответствующим уменьшением эффективной толщины высокоомной кремнийуглеродной матрицы. Однако, как было показано выше, при концентрациях исследуемых металлов до 4 at.% нанокристаллы в пленках вообще не наблюдаются. С другой стороны, в диапазоне концентраций металла от 0 до 4 at.% электропроводность пленок возрастает на дватри порядка величины (см. рис. 2).

При анализе причин изменения свойств кремнийуглеродных пленок при введении в них переходных металлов необходимо принять во внимание, что атомы металла в пленке для образования связей металл–углерод заимствуют углерод из кремний-углеродной матрицы. Это приводит к изменению структуры и свойств последней. Указанные изменения могут заключаться в следующем. Во-первых, как отмечалось в [2], изъятие



Рис. 1. ПЭМВР-изображения и дифракционные картины кремний-углеродных пленок с титаном (a, c) и гафнием (b, d) при содержании металла 2 at.% (a, b) и 20 at.% (c, d).

атомов углерода из структурной сетки ведет к росту концентрации оборванных связей и к увеличению плотности локализованных состояний в хвостах разрешенных зон. В свою очередь, это приводит к увеличению прыжковой проводимости в кремний-углеродной диэлектрической матрице. Во-вторых, как показали исследования спектров комбинационного рассеяния, введение в пленки аморфного углерода [12,13] и в кремний-углеродные пленки [14,15] некоторых переходных металлов (включая титан) приводит не только к образованию связей металл–углерод, но и к росту количества атомов углерода с sp^2 -гибридизацией электронных орбиталей в исходной кремний-углеродной структурной сетке, при соответствующем уменьшении концентрации атомов с sp^3 -гибридизацией. В свою очередь, возрастание доли атомов углерода с *sp*²-гибридизацией также должно приводить к увеличению электропроводности кремнийуглеродных пленок.

Указанные причины с одной стороны могут объяснить существенное изменение электропроводности пленок при введении небольших концентраций металла и отсутствии кристаллической карбидной фазы, а с другой стороны иллюстрируют необходимость учета изменений атомной структуры кремний-углеродной матрицы при химическом взаимодействии с вводимыми в образец атомами переходных металлов.

Зависимости действительной части диэлектрической проницаемости от частоты электрического поля при разных температурах для образцов с различным содержанием титана и гафния представлены на рис. 3, *a* и *b*.



Рис. 2. Зависимость электропроводности кремний-углеродных пленок от концентрации в них титана при разных температурах (штриховые линии) и гафния (сплошная линия).

Как видно из рисунков, действительная часть диэлектрической проницаемости для всех образцов имеет тенденцию к возрастанию с уменьшением частоты и с увеличением температуры. При этом величина указанных изменений зависит от концентрации металла в образце. В работе [7] было показано, что диэлектрическая проницаемость кремний-углеродных пленок на основе ПФМС без металла при высоких частотах (10^5-10^6 Hz) не зависит от частоты, а при уменьшении частоты менее 10^5 Hz она начинает возрастать. В отличие от этого в образцах, содержащих металл, изменения диэлектрической проницаемости наблюдается и в высокочастотном диапазоне. Однако, если для образцов с содержанием титана до 1 at.% эти изменения составляют доли процента (что близко к пределу точности измерений), для образцов с содержанием от 1 до 2 at.% изменения составляют единицы процентов, а у образца с содержанием металла 6 at.% — более 40%.

Возрастание значений диэлектрической проницаемости с увеличением температуры является характерной чертой полярных диэлектриков и обусловлено увеличением возможности ориентации диполей в электрическом поле. Причем плавный характер частотных зависимостей свидетельствуют о наличии в материале набора дипольных групп с различными временами релаксации поляризации. С уменьшением частоты приложенного электрического поля возрастает количество диполей, время релаксации которых (τ) обеспечивает возможность их участия в дипольно-ориентационной поляризации ($\tau \leq 1/2f$).

На рис. 4 показаны зависимости тангенса диэлектрических потерь от частоты электрического поля для кремний-углеродных пленок без металла (рис. 4, *a*) с титаном, с концентрацией 0.3 (рис. 4, *b*) и 1.8 at.% (рис. 4, *c*) и с гафнием, с концентрацией 4.5 at.%. Поскольку магнетронное распыление металла при изготовлении металлосодержащих пленок требует введение в рабочую камеру аргона, наличие которого также влияет на свойства пленок [2], то при изготовлении пленки без металла в рабочую камеру вводился аргон (с парциальным давлением 4.5 \cdot 10⁻⁴ Torr).

На зависимостях для образца с содержанием титана 0.3 at.% обнаруживаются два "плеча": в области частот порядка долей Hz при температурах выше 140°С ("плечо 1") и в области частот $1-10^3$ Hz при температурах выше 100°С ("плечо 2"). В случае образца с содержанием титана 1.8 at.% при температурах 60°С и выше "плечо 2" на зависимостях преобразуется в пик в области частот от 10 до 10^3 Hz, который с увеличением температуры сдвигается в область высоких частот. Как



Рис. 3. Зависимости действительной части диэлектрической проницаемости от частоты для образцов с титаном (*a*) и гафнием (*b*) с различным содержанием металла при 20°С (кружки), 100° С (квадраты) и 200°С (треугольники).



Рис. 4. Зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от частоты для образцов без металла (a), с титаном 0.3 at.% (b), 1.8 at.% (c) и гафнием 4.5 at.% (d) при разных температурах.

видно из рис. 4, d, аналогичный вид частотных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь наблюдается и в образцах с гафнием. Такой вид зависимостей является подтверждением дипольного характера поляризации материала и объясняется наличием двух составляющих диэлектрических потерь в материале: релаксационные потери и потери на сквозную проводимость.

Потери на сквозную проводимость возрастают с увеличением температуры (рис. 2), а температурная зависимость релаксационных потерь имеет максимум, обусловленный двумя конкурирующими процессами: ориентацией диполей в электрическом поле и их дезориентацией вследствие тепловых колебаний. Анализ частотных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь с учетом потерь на сквозную проводимость и флуктуаций высоты потенциального барьера диполей проводился в рамках модели "релаксатора Фрёлиха" [16] (рис. 5).

Согласно этой модели, у диполей в материале имеется два метастабильных состояния, разделенных потенциальным барьером W_{τ} . Переход через этот потенциальный барьер обеспечивает активационный характер времени релаксации:

$$\tau = \tau_0 \cdot \exp\left(\frac{W_\tau}{kT}\right),\tag{1}$$

где τ — значение времени релаксации, sec; τ_0 — предэксопненциальный множитель, sec; k — постоянная Больцмана; T — температура, K.

Тогда релаксационные потери описываются выражением

$$\operatorname{tg}\delta(\omega) = \operatorname{tg}\delta_m \frac{\operatorname{arctg}(\omega\beta/\omega_m) - \operatorname{arctg}(\omega/\omega_m\beta)}{\operatorname{arctg}(\beta) - \operatorname{arctg}(1/\beta)}, \quad (2)$$

где $\omega_m = 2\pi f_m$ — значение частоты, соответствующее положению максимума релаксационных потерь tg δ_m , 1/sec; $\beta = \sqrt{\tau_2/\tau_1}$ — параметр, характеризующий уширение спектра (при $\beta = 1$ выражение (2) преобразуется в формулу Дебая).

Полученные на основании этого анализа значения, входящие в выражение (2), сведены в таблицу.



Рис. 5. Численный анализ частотной зависимости тангенса угла диэлектрических потерь для образца с содержанием титана 1.8 at.% при температуре 200°С.

Анализ температурных зависимостей времен релаксации в координатах Аррениуса $\ln(\tau_1) - 1/T$ и $\ln(\tau_2) - 1/T$ дал значения энергии активации релаксационных процессов в диапазоне от 0.42 до 0.46 eV. Кроме того, согласно [16], величина β характеризует максимальный разброс высот потенциальных барьеров

$$\Delta W_{\tau} = W_{\text{max}} - W_{\text{min}} = 2kT \cdot \ln(\beta).$$
(3)

Исходя из данных таблицы, максимальный разброс высот потенциального барьера составляет $\Delta W_{\tau} = = (4.2 - 4.6)kT.$

Такой анализ позволил достаточно корректно воспроизвести указанные зависимости в окрестностях максимума и при более низких частотах. Вместе с тем, как видно из рис. 5, на кривых справа от максимума наблюдается "плечо", которое не описывается в рамках сделанных предположений. Причина возникновения этого "плеча" заключается, вероятно, в наличии в материале ни одного, а нескольких типов релаксаторов с различными временами релаксации.

Аналогичный анализ температурного сдвига положения максимумов пиков на частотных зависимостях тан-

Параметры релаксационных потерь образца с 1.8 at.% титана

<i>T</i> , °C	f_m , Hz	tg δ_m	β	τ_1 , sec	τ_2 , sec
60	4.0	0.43	6	$6.6\cdot10^{-3}$	0.24
80	7.2	0.54	10	$2.2\cdot10^{-3}$	0.22
100	21.6	0.48	10	$7.4\cdot 10^{-4}$	$7.4 \cdot 10^{-2}$
120	27.0	0.53	8	$7.4\cdot 10^{-4}$	$4.7 \cdot 10^{-2}$
140	54.0	0.50	10	$3.0\cdot10^{-4}$	$3.0\cdot10^{-2}$
160	135.6	0.44	10	$1.2\cdot 10^{-4}$	$1.2\cdot 10^{-2}$
180	210.0	0.47	8	$9.5 \cdot 10^{-5}$	$6.1 \cdot 10^{-3}$
200	350.0	0.48	9	$5.1 \cdot 10^{-5}$	$4.1 \cdot 10^{-3}$

генса угла диэлектрических потерь пленок без металла (рис. 4, a) и пленок с гафнием (рис. 4, d) показал, что энергия активации пика В в пленках без металла составляет 0.39 eV, а в пленках с гафнием 0.42 eV. Таким образом, энергии активации процессов релаксации во всех исследованных образцах близки друг к другу. Кроме того, положения пиков/плеч на рассматриваемых зависимостях для всех трех групп образцов также находятся в одном диапазоне частот. Данные факторы свидетельствуют о том, что как в пленках без металла, так и в пленках с невысоким содержанием металлов релаксаторы имеют одну и ту же природу и формируются в исходной кремний-углеродной матрице.

Из частотных зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь (рис. 4) следует еще один интересный факт. У образца с содержанием титана 0.3 аt.% наблюдаемое в области десятков-сотен герц "плечо 2" по абсолютному значению практически на порядок ниже, чем пик в образце с 1.8 at.% титана и пик В в образце без металла (несмотря на меньшие потери на сквозную проводимость в последнем). Это свидетельствует о меньшем содержании релаксаторов в образце с 0.3 at.% титана по сравнению не только с образцом с бо́льшим содержанием титана, но с образцом, в котором металл отсутствует. Для анализа этого явления необходимо рассмотреть концентрационные зависимости свойств.

На рис. 6, а представлены зависимости диэлектрической проницаемости образцов при разной частоте измерений от концентрации введенных в них титана и гафния, а на рис. 6, b концентрационные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь для образцов с титаном. Характер концентрационных зависимостей tg δ для образцов с гафнием имеет такой же характер.

Из рисунков видно, что как на зависимости диэлектрической проницаемости, так и на зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от концентрации в пленке металла наблюдается минимум при содержании металла около 0.5-2 at.%. При этом проводимость пленок с увеличением концентрации металла (рис. 2) непрерывно возрастает. Таким образом, при малых концентрациях введение металла вызывает рост проводимости и уменьшение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Поскольку тангенс угла диэлектрических потерь зависит как от сквозной проводимости, так и от релаксационных потерь в образце, это свидетельствует, что введение металла при малых его концентрациях уменьшает релаксационные потери. Причем уменьшает их сильнее по сравнению с потерями на сквозную проводимость, которые растут при введении в пленку металла. Другими словами, введение металла в малых концентрациях (до 2 at.%) приводит к уменьшению количества релаксаторов в материале. Для этого вводимый металл должен либо компенсировать дипольные моменты существующих релаксаторов, либо, что более вероятно, разрушать диполи, существующие в исходной матрице, за счет образования связей металлуглерод и, возможно, металл-кислород.



Рис. 6. Концентрационные зависимости диэлектрической проницаемости (*a*) (сплошная линия — для пленок с титаном, штриховая — для пленок с гафнием) и тангенса угла диэлектрических потерь (*b*) металлсодержащих кремний-углеродных пленок.

При увеличении концентрации металла более 2 at.% возрастает объем фазы, содержащей соединения металла с элементами структурной сетки кремний-углеродной пленки, например, с углеродом. Эта фаза имеет повышенную электропроводность по сравнению с исходной матрицей. Благодаря этому возникает межфазная поляризация, приводящая к росту диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Такой вид поляризация для композитных материалов известен как поляризация Максвелла-Вагнера и наблюдался в работе [17] при исследовании пленок аморфного алмазоподобного углерода, модифицированных цинком. В работе показано, что при увеличении содержания цинка до 4 at.% происходит монотонное возрастание диэлектрической проницаемости. Однако наличие минимума в области малых концентраций металла в работе обнаружено не было. Возможно, это связано с тем, что в пленках алмазоподобного углерода вводимый металл может соединиться только с атомами углерода, а в кремний-углеродных пленках могут реализовываться соединения металла с различными элементами структурной сетки [18].

5. Заключение

Проведенные исследования влияния переходных металлов на электрофизические свойства кремнийуглеродных пленок на основе PPMS показали различный характер концентрационных зависимостей исследованных свойств. Так, электропроводность пленок непрерывно возрастает с увеличением концентрации металла, а зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь имеют минимум в диапазоне концентраций металла 0.5–2.0 at.% металла. Уменьшение значений диэлектрических свойств при введении относительно небольших концентраций металла (несмотря на рост сквозной проводимости) свидетельствует о существенном снижении релаксационных потерь в материале. Причина этого явления может заключаться в разрушении существующих в исходной матрице диполей за счет образования соединений металла с элементами структурной сетки (углеродом и кремнием). При этом необходимо отметить, что высказанное предположение является гипотезой, для подтверждения которой необходимо проведение экспериментов по количественному определению наличия и концентрации химических связей атомов металла с элементами структурной сетки при разных концентрациях металла.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 19-07-00021).

Часть экспериментальных работ была выполнена на оборудовании Ресурсного центра зондовой и электронной микроскопии (Курчатовский комплекс НБИКС — природоподобных технологий, НИЦ "Курчатовский институт").

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- Š. Meškinis, A. Tamulevičienė. Mater. Sci. (Medžiagotyra) 17, 4, 358 (2011).
- [2] А.И. Попов, А.Д. Баринов, В.М. Емец, Т.С. Чуканова, М.Л. Шупегин. ФТТ 62, 10, 1612 (2020).

[3] F. Mangolini, B.A. Krick, T.D.B. Jacobs, S.R. Khanal, F. Streller, J.B. McClimon, J. Hilbert, S.V. Prasad, T.W. Scharf, J.A. Ohlhausen, J.R. Lukes, W.G. Sawyer, R.W. Carpick. Carbon. 130, 127 (2018).

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.12.096

- [4] E.V. Zavedeev, O.S. Zilova, M.L. Shupegin, A.D. Barinov, N.R. Arutyunyan, T. Roch, S.M. Pimenov. Appl. Phys. A 122, 961 (2016). DOI: 10.1007/s00339-016-0508-7
- [5] М.А. Величко, Ю.П. Гладких. Науч. вед-ти Белгородского нац. исслед. ун-та. Сер. Математика. Физика 6, 227; 42, 115 (2016).
- [6] А.Д. Баринов, А.И. Попов, М.Ю. Пресняков. Неорган. материалы 53, 7, 706 (2017).
- [7] А.Д. Баринов, Т.Д. Гуринович, А.И. Попов, Т.С. Чуканова, М.А. Шапетина, М.Л. Шупегин. Неорган. материалы. 56, 8, 844 (2020).
- [8] A. Popov. Disordered Semiconductors: Physics and Application. 2nd ed. Pan Stanford Publish. (2018). 328 p.
- [9] М.Д. Малинкович, Ю.Н. Пархоменко, Д.С. Поляков, М.Л. Шупегин. Материалы электронной техники 1, 3, 41 (2010).
- [10] T. Tamulevičius, D. Tamulevičiené, A. Virganavičius, V. Vasiliauskas, Š. Kopustinskas, S. Meškinis. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B 341, 1 (2014).
- [11] М.Ю. Пресняков, А.И. Попов, Д.С. Усольцева, М.Л. Шупегин, А.Л. Васильев. Рос. нанотехнологии **9**, 7–8, 70 (2014).
- [12] D.B.K. Sheeja, C.Q. Tay et al. J. Mater. Sci. 38, 421 (2003).
- [13] C.M. Adelhelm, M. Balden, Rinke et al. J. Appl. Phys. 105, 033522 (2009).
- [14] A. Bozhko, T. Takagi, T. Takeno. J. Phys. Condens. Matter 16, 46, 8447 (2004).
- [15] S.M. Pimenov, E.V. Zavedeev, N.R. Arutyunyan, O.S. Zilova, A.D. Barinov, M.Yu. Presniakov, M.L. Shupegin. Surface & Coatings Technology 402, 126300 (2020).
- [16] Г. Фрёлих. Теория диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери. ИЛ, М. (1960). 251 с.
- [17] A.K. Das, R. Hatada, W. Ensinger. J. Alloys Comp. 758, 194 (2018).
- [18] А.И. Попов, В.П. Афанасьев, А.Д. Баринов Ю.Н. Бодиско, А.С. Грязев, И.Н. Мирошникова, М.Ю. Пресняков, М.Л. Шупегин. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования 9, 49 (2019).

Редактор К.В. Емцев